

半導體設備與製程技術種子教師課程

■課程簡介

此課程旨在培育具備實務經驗的師資，課程內容涵蓋雷射技術發展、ai 晶片、先進封裝、光學檢量測、智慧製造、ESG 等。透過專業講師授課與實作演練，強化教師對產業現況與技術應用的理解，提升教學深度與廣度，進而推動半導體人才永續發展。

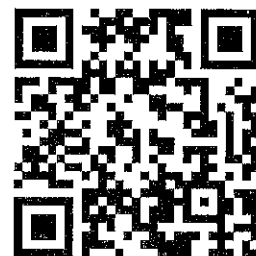
■課程資訊

📅 活動時間：2025 年 9 月 23 日 (二) – 9 月 24 日 (三)

📍 活動地點：台北市(實際地點依報到通知為準)

👥 參加對象：大專校院相關科系教師、專業師資

🔗 報名連結：<https://www.surveycake.com/s/4GAv6>



報名請掃 QR code

■課程大綱

114 年 9 月 23 日(二)		
時間	議題	講師
09:00-09:30	報到	
09:30-11:00	- 機械手臂組成與實務操作 - 機械手臂機構與系統組成 - 機械手臂使用安全 - 機械手臂實務操作 - 機械手臂與應用整合 - 機械手臂自動化系統 - 應用案例與技術 - AI 自動化與機械手臂 - AI 自動化系統架構 - 機械手臂與人工智能 - 實際應用案例	台灣庫卡 黃麟欽 經理
11:00-12:30	自動光學檢量測設備簡介 - 前言與產業背景 - 自動光學檢測 (AOI) 與量測設備核心技術簡介 - 產業實務面與挑戰	晶彩科技 葉東益 研發副總經理
12:30-13:30	午餐	